
**Revêtements métalliques et autres
revêtements inorganiques — Dépôts
autocatalytiques de nickel sur dépôts
autocatalytiques de cuivre pour
protection contre les interférences
électromagnétiques**

*Metallic and other inorganic coatings — Autocatalytic nickel over
autocatalytic copper for electromagnetic shielding*

iTeh Standards
(<https://standards.iteh.ai/>)
Document Preview

[ISO 17334:2008](https://standards.iteh.ai/catalog/standards/iso/98c06514-fâff-409e-9413-a0d497e4f4bc/iso-17334-2008)

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/iso/98c06514-fâff-409e-9413-a0d497e4f4bc/iso-17334-2008>



PDF – Exonération de responsabilité

Le présent fichier PDF peut contenir des polices de caractères intégrées. Conformément aux conditions de licence d'Adobe, ce fichier peut être imprimé ou visualisé, mais ne doit pas être modifié à moins que l'ordinateur employé à cet effet ne bénéficie d'une licence autorisant l'utilisation de ces polices et que celles-ci y soient installées. Lors du téléchargement de ce fichier, les parties concernées acceptent de fait la responsabilité de ne pas enfreindre les conditions de licence d'Adobe. Le Secrétariat central de l'ISO décline toute responsabilité en la matière.

Adobe est une marque déposée d'Adobe Systems Incorporated.

Les détails relatifs aux produits logiciels utilisés pour la création du présent fichier PDF sont disponibles dans la rubrique General Info du fichier; les paramètres de création PDF ont été optimisés pour l'impression. Toutes les mesures ont été prises pour garantir l'exploitation de ce fichier par les comités membres de l'ISO. Dans le cas peu probable où surviendrait un problème d'utilisation, veuillez en informer le Secrétariat central à l'adresse donnée ci-dessous.

iTeh Standards
(<https://standards.iteh.ai>)
Document Preview

[ISO 17334:2008](https://standards.iteh.ai/catalog/standards/iso/98c06514-faff-409e-9413-a0d497e4f4bc/iso-17334-2008)

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/iso/98c06514-faff-409e-9413-a0d497e4f4bc/iso-17334-2008>



DOCUMENT PROTÉGÉ PAR COPYRIGHT

© ISO 2008

Droits de reproduction réservés. Sauf prescription différente, aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ni utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé, électronique ou mécanique, y compris la photocopie et les microfilms, sans l'accord écrit de l'ISO à l'adresse ci-après ou du comité membre de l'ISO dans le pays du demandeur.

ISO copyright office
Case postale 56 • CH-1211 Geneva 20
Tel. + 41 22 749 01 11
Fax + 41 22 749 09 47
E-mail copyright@iso.org
Web www.iso.org

Publié en Suisse

Sommaire

Page

Avant-propos.....	iv
Introduction.....	v
1 Domaine d'application	1
2 Références normatives	1
3 Termes et définitions	2
4 Informations essentielles à fournir par l'acheteur	2
5 Désignation	3
5.1 Généralités	3
5.2 Type de revêtement	4
5.3 Qualité de revêtement	4
5.4 Exemples de désignations	4
6 Exigences	5
6.1 Substrat	5
6.2 Aspect	5
6.3 Stockage	5
6.4 Composition du dépôt	6
6.5 Épaisseur locale du dépôt	6
6.6 Adhérence	6
6.7 Continuité électrique et intégrité	6
6.8 Cycle thermique	6
6.9 Efficacité du blindage	7
6.10 Éprouvettes spéciales	7
7 Échantillonnage	7
Annexe A (normative) Méthodes de mesurage de l'épaisseur	8
Bibliographie	9

Avant-propos

L'ISO (Organisation internationale de normalisation) est une fédération mondiale d'organismes nationaux de normalisation (comités membres de l'ISO). L'élaboration des Normes internationales est en général confiée aux comités techniques de l'ISO. Chaque comité membre intéressé par une étude a le droit de faire partie du comité technique créé à cet effet. Les organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec l'ISO participent également aux travaux. L'ISO collabore étroitement avec la Commission électrotechnique internationale (CEI) en ce qui concerne la normalisation électrotechnique.

Les Normes internationales sont rédigées conformément aux règles données dans les Directives ISO/CEI, Partie 2.

La tâche principale des comités techniques est d'élaborer les Normes internationales. Les projets de Normes internationales adoptés par les comités techniques sont soumis aux comités membres pour vote. Leur publication comme Normes internationales requiert l'approbation de 75 % au moins des comités membres votants.

L'attention est appelée sur le fait que certains des éléments du présent document peuvent faire l'objet de droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. L'ISO ne saurait être tenue pour responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence.

L'ISO 17334 a été élaborée par le comité technique ISO/TC 107, *Revêtements métalliques et autres revêtements inorganiques*, sous-comité SC 3, *Dépôts électrolytiques et finitions apparentées*.

iteh Standards
(<https://standards.iteh.ai/>)
Document Preview

[ISO 17334:2008](https://standards.iteh.ai/catalog/standards/iso/98c06514-faff-409e-9413-a0d497e4f4bc/iso-17334-2008)

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/iso/98c06514-faff-409e-9413-a0d497e4f4bc/iso-17334-2008>

Introduction

La prolifération des équipements électroniques a créé un besoin de méthodes de protection des composants contre les risques de rayonnement électromagnétique, risques qui peuvent entraîner le dysfonctionnement des ordinateurs ainsi que des équipements médicaux, de navigation, de détonation, de télécommunication et autres dispositifs. Les exigences en matière de protection contre les interférences électromagnétiques ont été établies par des réglementations et des directives gouvernementales dans de nombreuses régions du monde.

La protection offerte par une enceinte, un boîtier ou une armoire contre l'émission ou l'absorption du rayonnement électromagnétique dépend de sa conductivité; c'est pourquoi, les boîtiers métalliques se révèlent très efficaces dans la protection contre les interférences électromagnétiques. Les avantages des matières plastiques en termes de coût et de poids ont toutefois conduit à leur large utilisation dans les armoires informatiques et autres boîtiers. Les matières plastiques sont non conductrices et par conséquent, des méthodes de revêtement métallique ont été développées pour protéger les composants contre les interférences engendrées par le rayonnement électromagnétique.

Une méthode efficace de protection des boîtiers d'ordinateur contre les interférences électromagnétiques est le dépôt autocatalytique d'une couche de cuivre sur le boîtier en plastique. Pour garantir la durabilité et la protection anti-corrosion, une fine couche de nickel autocatalytique est appliquée sur le cuivre autocatalytique. Bien que cette méthode ait d'abord été utilisée dans les boîtiers d'ordinateur en plastique, elle est applicable à d'autres supports et applications. Le recours à une protection efficace risque fort de s'intensifier et une augmentation de l'utilisation de dépôts autocatalytiques de nickel sur des dépôts autocatalytiques de cuivre à des fins de protection contre les interférences électromagnétiques est prévue.

La présente Norme internationale s'adresse aux acheteurs pour la spécification des exigences à l'intention de l'électroplaste, du fournisseur ou du préparateur et est à mentionner sur le plan ou le bon de commande.

<https://standards.iteh.ai>
Document Preview
ISO 17334:2008

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/iso/98c06514-faff-409e-9413-a0d497e4f4bc/iso-17334-2008>

